

RL78/G1G グループ半田付け条件判定表

RL78/G1G GROUP SOLDERING CONDITIONS TABLE

R01ZZ0153XJ0100-RL78G1G-JE

本資料の内容は変更されることがありますので、納入仕様書で最新情報をご確認ください。

The contents of this document are subject to change, so please check the latest information by delivery specifications.

“○”：適用可，“－”：適用不可  
 “○”：applicable，“－”：not applicable

パッケージ名 Package	型名 Part Number	リフロ条件 INFRARED REFLOW	ウェーブソルダリング条件 WAVE SOLDERING	部分加熱条件 PARTIAL HEATING
		RDK-J-000312(JP) (旧番号:SSD-A-M5658-2)(JP)	RDK-J-000313(JP) (旧番号:SSD-A-M5660-3)(JP)	RDK-J-000314-2(JP,EN) (旧番号:SSD-A-M5662-1)(JP)
		RDK-J-000318-2(EN) (Old number:SSD-A-M5659-1(EN))	RDK-J-000319-2(EN) (Old number:SSD-A-M5661-1(EN))	(旧番号:SSD-A-M5663)(EN)
30-pin plastic LSSOP (7.62 mm (300))	R5F11EAxASP	○	○	○
32-pin plastic LQFP (7 x 7 mm 0.8 mm pitch)	R5F11EBxAFP	○	○	○
44-pin plastic LQFP (10 x 10 mm 0.8mm pitch)	R5F11EFxAFP	○	○	○

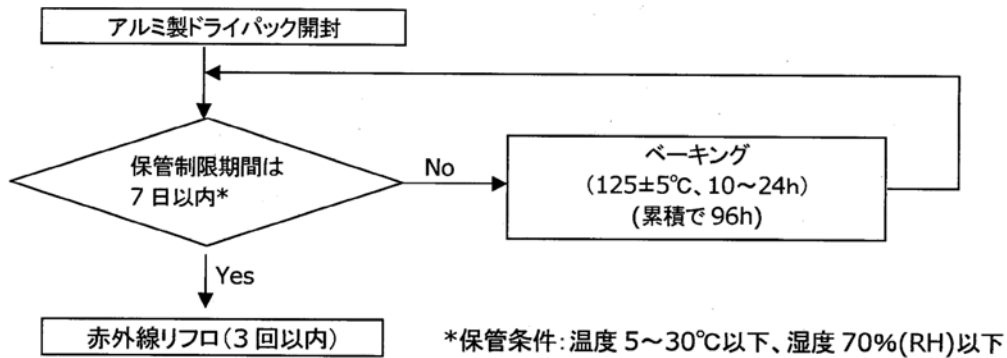
実装条件  
赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件  
[温風、赤外線、温風リフロを含む]  
吸湿量管理品

MSL3

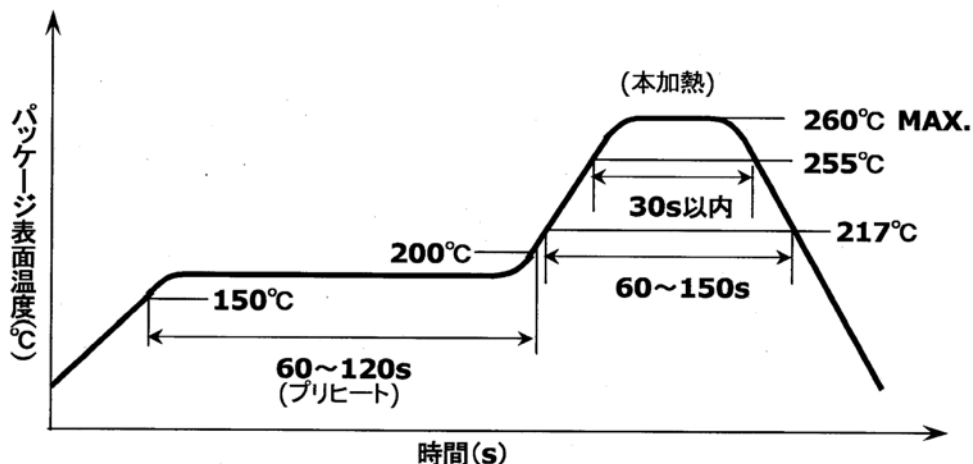
RDK-J-000312 1/1

ルネサス エレクトロニクス株式会社  
Renesas Electronics Corporation

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(260°Cの場合) : 260°C MAX
- ピーク温度(-5°C)の時間 : 255°C 30s 以内
- はんだ融点以上(217°C以上の時間) : 60~150s
- プリヒート領域(150~200°Cの時間) : 60~120s
- 最多リフロ回数 : 3回
- ドライパック開封後の保管制限期間 : 7日以内



<赤外線リフロ温度プロファイル>

留意事項

- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの30%検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用をお願いいたします。

**Mount Conditions**  
**RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS**  
**OF INFRARED REFLOW**

[INCLUDING CONVECTION, INFRARED/CONVECTION]

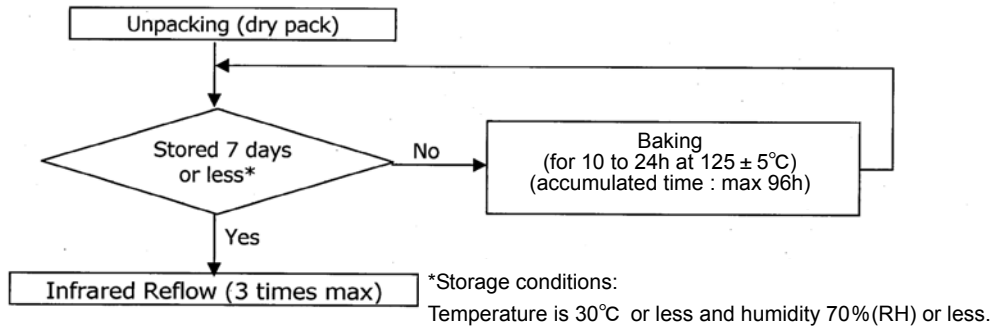
**Moisture sensitive device**

MSL3

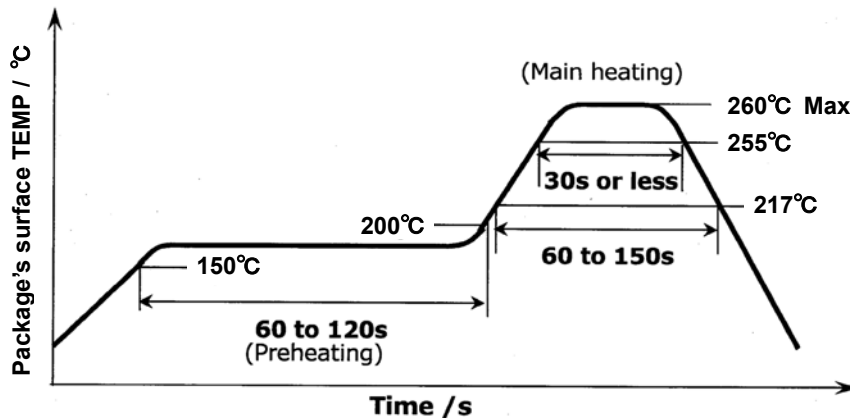
RDK-J-000318-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.



Maximum temperature (Package's surface TEMP)	:260°C or below
Maximum time for temperature higher than 255°C	:30s or less
Time for temperature higher than 217°C	:60 to 150s
Preheating time (150 to 200°C)	:60 to 120s
Maximum number of reflow processes	:3 times
Keeping limitation period after opening dry pack	:7 days or less



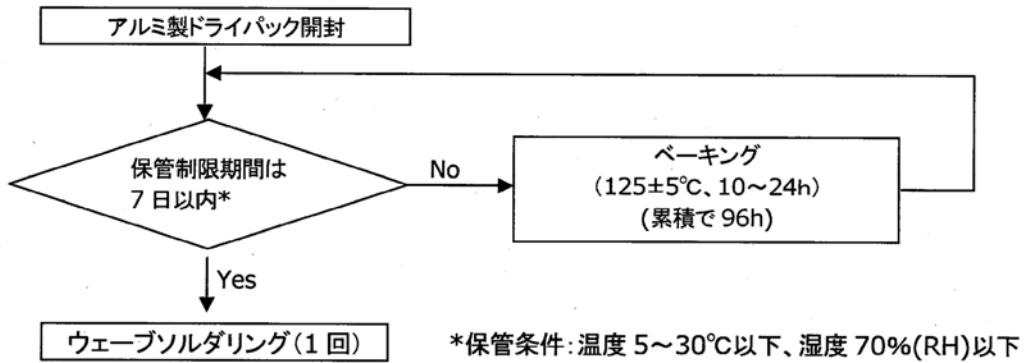
<Infrared Reflow Temperature Profile>

**Notice**

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

<p style="text-align: center;">実装条件</p> <p style="text-align: center;">ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">吸湿量管理品</div> <p style="text-align: right;">MSL3</p>	RDK-J-000313 1/1
	<p>ルネサス エレクトロニクス株式会社</p> <p>Renesas Electronics Corporation</p>

ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(はんだ温度) : 260°C以下
- ピーク温度の時間(一次+二次噴流通過時間) : 10s 以内
- 回数 : 1 回
- プリヒート温度(PKG 表面温度) : 120°C MAX
- プリヒート時間 : 制限無し

**留意事項**

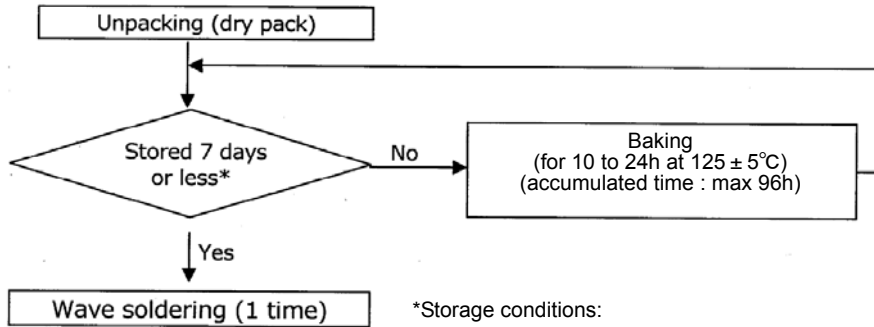
- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの 30% 検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用お願いいたします。

Mount Conditions  
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS  
OF WAVE SOLDERING  
Moisture sensitive device

RDK-J-000319-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of wave soldering.



\*Storage conditions:  
Temperature is 30°C or less and humidity 70%(RH) or less.

Maximum temperature (Solder temperature)	:260°C or below
Time at maximum temperature	:10s or less
Maximum number of flow processes	:1 time
Maximum preheating temperature (Product's surface temp.)	:120°C or below
Maximum preheating time	:No limitation

**Notice**

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container.
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

実装条件 部分加熱方式のはんだ付け推奨条件 表面実装部品 Mount Conditions RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS OF PARTIAL HEATING Surface mount device	RDK-J-000314-2 1/1
	ルネサス エレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

- 最高温度(端子温度) : 350°C以下
- 時間(パッケージの一边あたり) : 3s 以内
- 最多回数 : 1 回

The following is recommended soldering conditions of partial heating.

- Maximum temperature (Pin temperature) : 350°C or below
- Time (per side of the device) : 3s or less
- Maximum number of heating processes : 1time